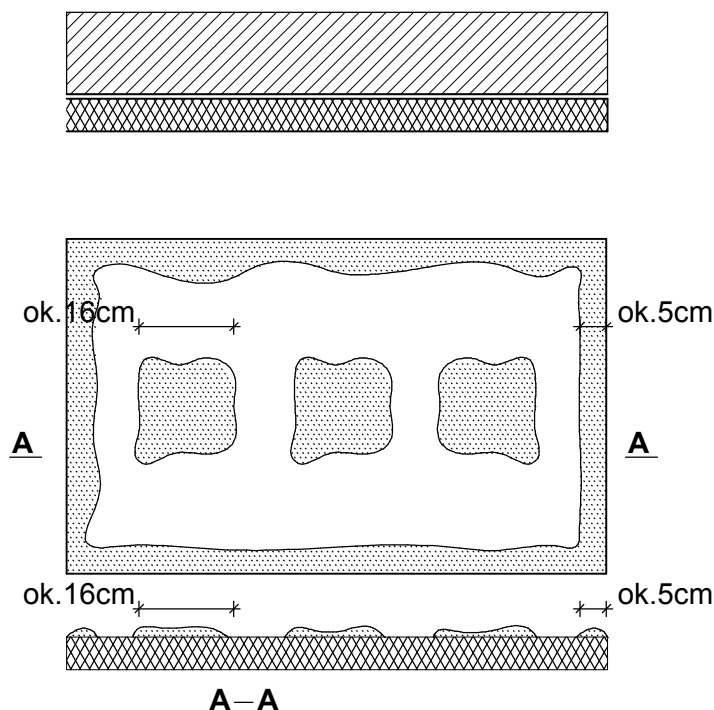


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej



$$\frac{P_e}{P} \times 100\% \geq 40\%$$

Pe- efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P- powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGA:

Do klejenia izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych podłoży budowlanych, gotowych zapraw klejowych (mieszanych z wodą na budowie).

Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

Klej należy nanieść na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub punktową.

Na płytę nanosić taką ilość zaprawy aby uwzględnić odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia wstęgę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia do podłoża.

Przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10mm).

INWESTOR :			
Powiat w Szydłowcu Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec			
BIURO PROJEKTÓW : NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ		SKALA	
OBIEKT / ADRES : WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO		STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
DZIAŁKI NR: Szydłowiec, ul. Kolejowa 78		BRANŻA	ARCH.
PROJEKT : ARCHITEKTURA		DATA	06.2008r
TYTUŁ RYSUNKU : Sposób klejenia płyt izolacji termicznej		NR RYS.	PBW/A/09
IMIĘ NAZWISKO		Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2008r
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK		06.2008r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL - 11/92 spec.arch.	06.2008r